



SCIENTECH

辛耘企業 (3583)

September 12, 2013

主要產品

自製
設備

半導體暨光電
前段、先進封裝
濕製程設備

設備
代理

半導體暨光電
製程及量測設備

再生
晶圓

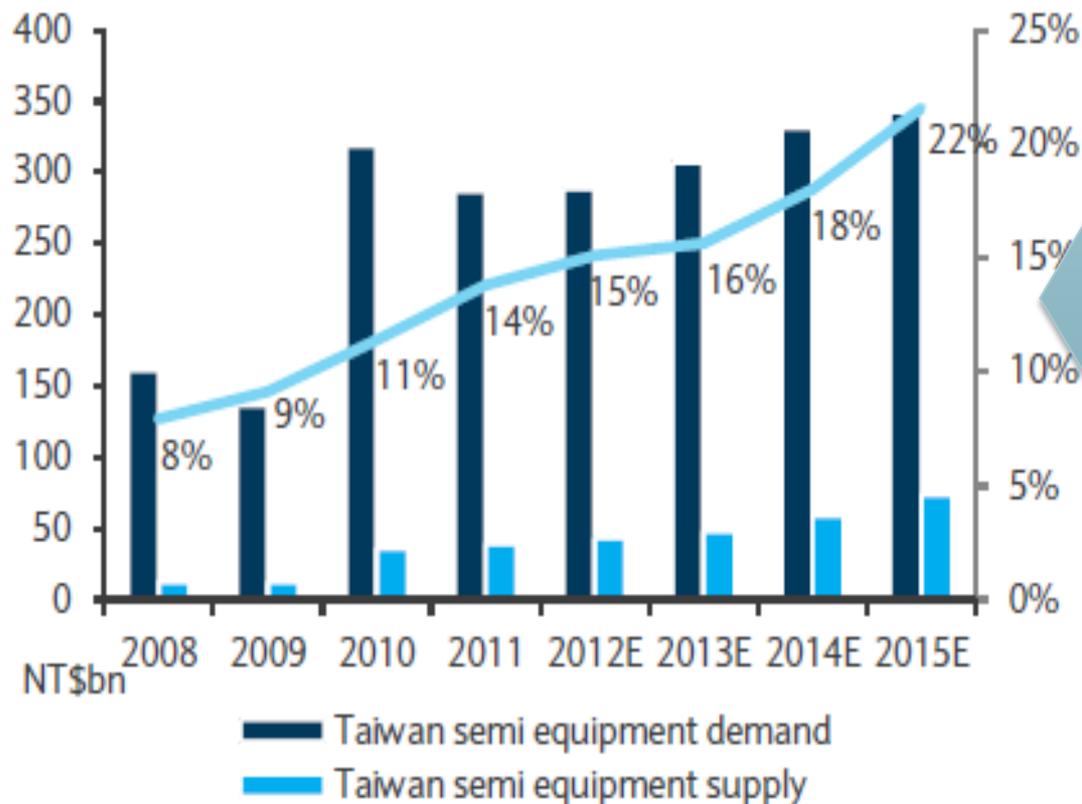
12吋再生晶圓

- 濕製程設備
 - 單晶圓/批次濕式製程設備
 - ◆ 8"/12"先進封裝製程:
Bumping/TSV/3D
 - ◆ 6"/8"前段製程
 - ◆ 中小尺寸半導體前段製程:
微機電 (MEMS) + III V族
 - ◆ LED全自動前段製程

濕製程設備，由於應用之製程多（清洗、顯影、去光阻、蝕刻...），佔半導體廠設備資本支出之15%，達49.8億美元。



Taiwan semi equipment demand/supply



- Taiwan semi equipment supply estimated
 - 2013: 16%
 - 2014: 18%
 - 2015: 22%
- High growth of local supply

Source: Metal Industry Intelligence estimates, Barclays Research

Advanced clean technology

- 65nm/ 45nm Particle
- Low trace metal (<1E10)



Complete particle inspection (SP1-DLS & SP2)

Cleaning

Etching

Full Process
Optimization



Polishing

Grinding

Complete polishing process

Super flatness (GBIR<0.5 μ m)



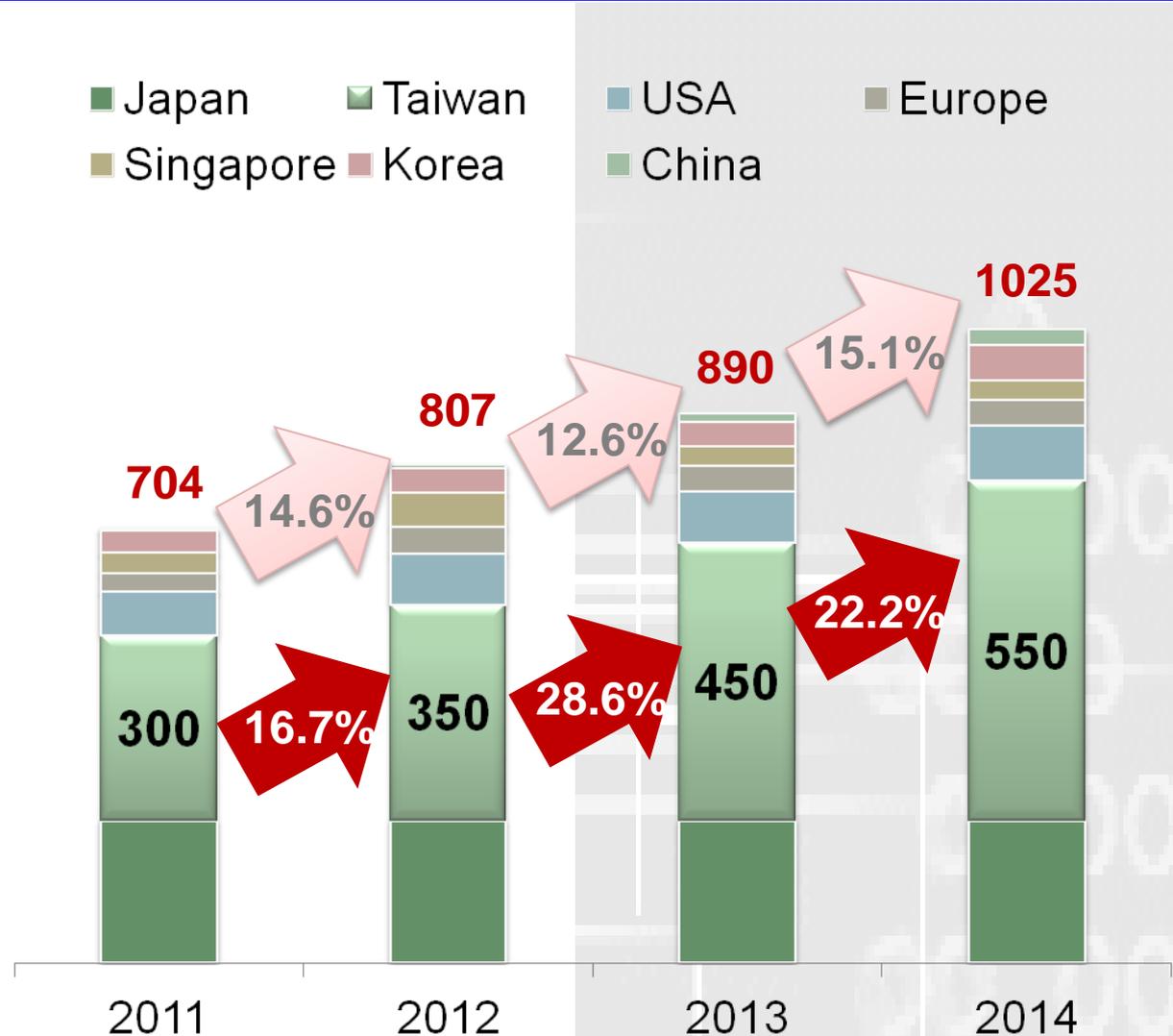
- 12" Wafer Reclaim
- 月產能: 120K
- 銅製程與非銅製程產線分離。
- 目前台灣唯一具備有可快速擴廠能力之再生晶圓廠

主要產品

晶圓再生服務



- IC Insight: 台灣擁有全球第二的 12吋晶圓生產能力(DRAM + foundry)，佔約 **25.4%**。2013年將超過100萬片/月。
- 台灣12吋晶圓代工高階製程快速演進成長，帶動2013年 12吋再生晶圓需求成長達 **28%** 以上，遠高於12.6%的全球成長率。
- 12"晶圓再生服務之需求強勁，將驅動辛勤晶圓再生服務之營收。



主要產品

代理設備



Canon

Revera



PONGSAN MICROTEC

xradia
insight in 3D

FerroTec

GIGAPHOTON

USHIO

LCP
PLASMA TECHNOLOGIES

VLSI Standards
Incorporated

FRT

NAKAN

Kensington
LABORATORIES

Verity
INSTRUMENTS, INC.

ΔE ADVANCED
ENERGY®

KLA Tencor
Already there

BECKMAN
COULTER

Ayumi
アユミ工業株式会社
AYUMI INDUSTRY CO., LTD.

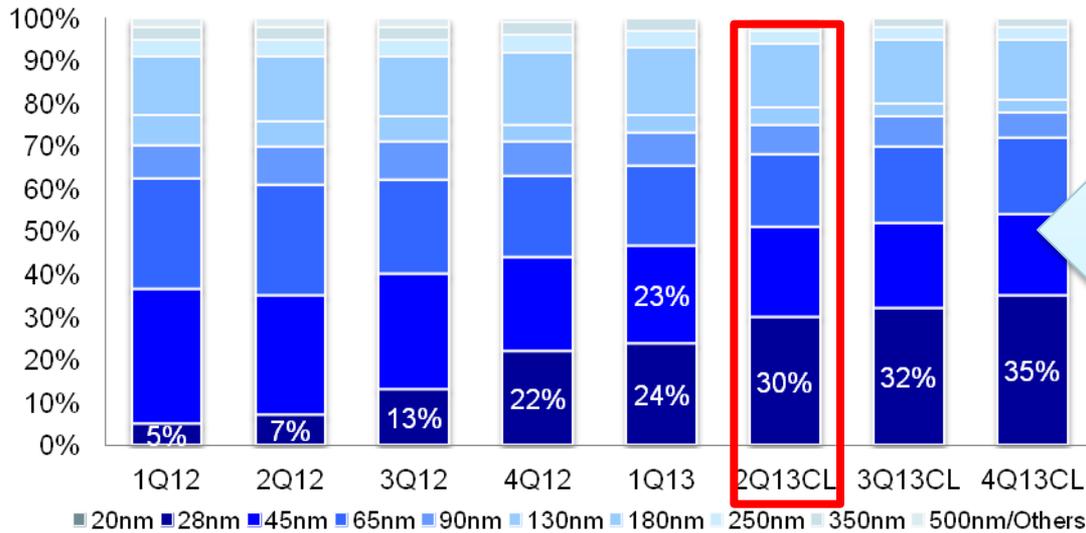
NST [주] 엔에스티
NST INC.

e²

RUDOLPH
RESEARCH
ANALYTICAL

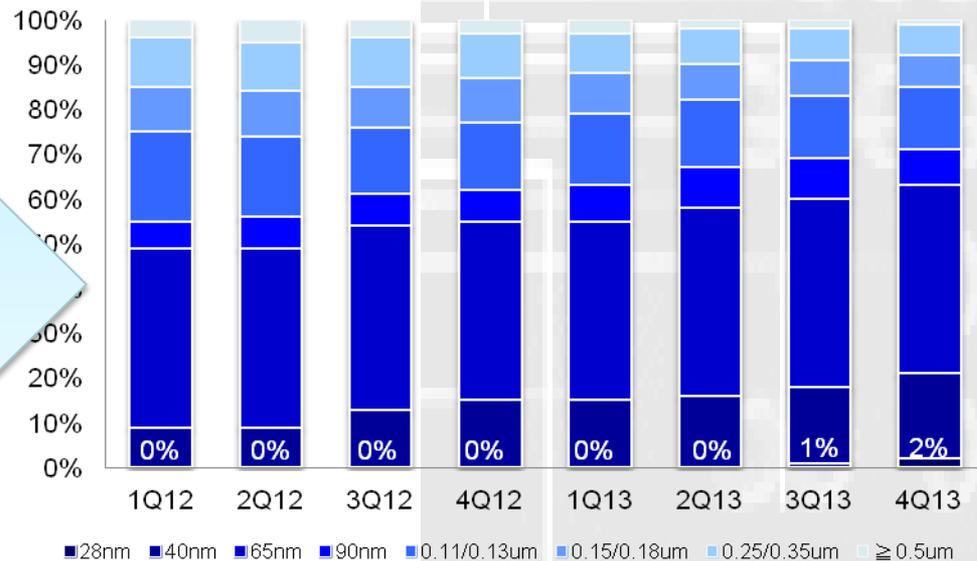


TSMC / UMC



2013年第一季起，28奈米產品線已成為台積電新的營收主力。

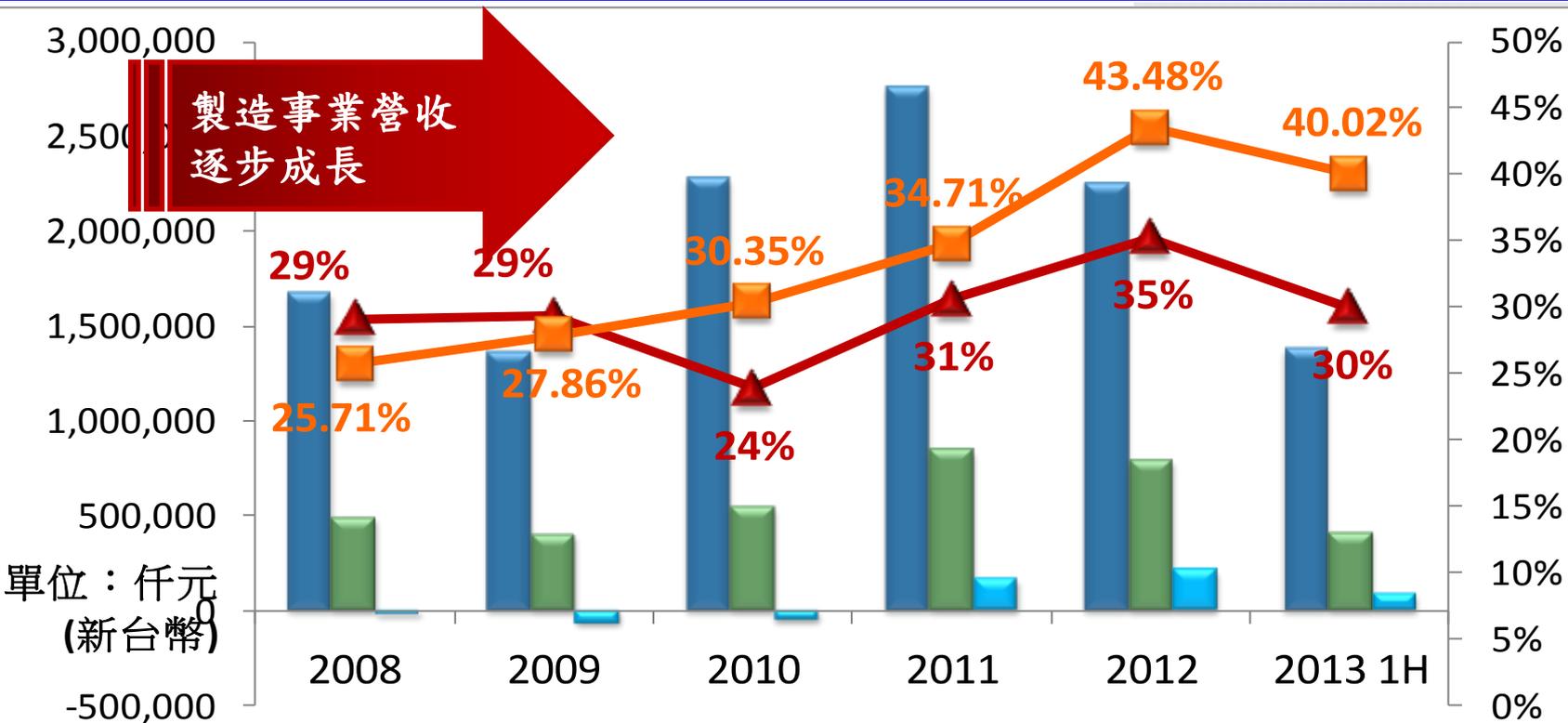
2013年下半年起，28奈米產品線開始挹注聯電營收貢獻。



科目	2010	2011	2012	2012/1Q	2012/1H	2013/1Q	2013/1H
營業收入	2,275,507	2,761,318	2,252,295	460,541	985,534	613,076	1,380,685
營業毛利	542,939	844,247	793,275	148,067	344,739	185,232	413,323
毛利率	24%	31%	35%	32%	35%	30%	30%
營業費用	551,760	658,733	581,512	142,914	306,362	151,079	307,487
推銷費用	348,456	409,319	349,484	87,416	189,300	91,356	183,220
管理費用	89,740	119,987	110,724	24,871	53,339	30,727	62,239
研發費用	113,564	129,427	121,304	30,627	63,723	28,996	62,028
營業淨利(損)	(8,821)	185,514	211,763	5,153	38,377	34,153	105,836
營業外收入	23,164	19,114	40,864	4,134	10,349	11,091	20,280
營業外支出	63,697	40,866	41,789	14,786	25,987	3,195	13,931
稅前損益	(49,354)	163,762	210,838	(5,499)	22,739	42,049	112,185
所得稅費用(利益)	9,230	84,742	34,622	(8,233)	10,017	8,195	27,801
稅後純益(損)	(58,584)	79,020	176,216	2,734	12,722	33,854	84,384
母公司股東淨利	5,560	77,079	176,216	2,734	12,722	33,854	84,384
少數股權	(64,144)	1,941	-	-	-	-	-
EPS(元)	0.09	1.21	2.38	0.04	0.17	0.45	1.08

營運概況

合併營收與毛利率 成長分析



營業收入	1,672,775	1,366,513	2,275,507	2,761,318	2,252,295	1,380,685
毛利率	29%	29%	24%	31%	35%	30%
稅後純益(損)	(25,287)	(3,163)	(58,584)	79,020	176,216	84,384
EPS	0.02	0.80	0.09	1.21	2.38	1.08

■ 營業收入
 ■ 營業毛利
 ■ 稅後純溢(損)
 ▲ 營業毛利率
 ■ 製造事業營收%

自製設備

- 國內半導體設備本土化產業趨勢確立。
- 高階封裝凸塊製程及矽穿孔 2.5D IC 對濕製程設備需求快速成長。
- MEMS、砷化鎵及LED先進製程全自動化需求確立。

晶圓再生

- 台灣12吋再生晶圓需求成長幅度達28.6%，遠高於12.6%的全球成長率。
- 在週轉率及成本最佳化的需求條件下，本土化是唯一趨勢。
- 晶圓再生海外產能萎縮，且無新擴建或技術提昇計畫，台灣再生晶圓服務有機會接全球半導體廠訂單。

代理設備

- 2013年28奈米將超越40奈米產品線成為台積電新的營收主力。
- 辛耘獨家代理數項半導體高階產品，為28/20奈米製程不可或缺之設備。
- 中國市場需求強勁。